



Initial Product/Process Change Notification

Document #: IPCN23955X

Issue Date: 01 Apr 2021

Title of Change:	Addition of an alternate polyimide material at JCAP
Proposed First Ship date:	17 Dec 2021 or earlier if approved by customer
Contact Information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or Keiji.Ueda@onsemi.com
PCN Samples Contact:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or PCN.samples@onsemi.com . Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.
Type of Notification:	This is an Initial Product/Process Change Notification (IPCN) sent to customers. An IPCN is an advance notification about an upcoming change and contains general information regarding the change details and devices affected. It also contains the preliminary reliability qualification plan. The completed qualification and characterization data will be included in the Final Product/Process Change Notification (FPCN). This IPCN notification will be followed by a Final Product/Process Change Notification (FPCN) at least 90 days prior to implementation of the change. In case of questions, contact PCN.Support@onsemi.com
Marking of Parts/ Traceability of Change:	Affected products will be traceable by date code.
Change Category:	Assembly Change
Change Sub-Category(s):	Material Change

Sites Affected:

ON Semiconductor Sites

None

External Foundry/Subcon Sites

JCAP, China

Description and Purpose:

This Initial Notification announces the addition of an alternate polyimide material (re-passivation layer) from Asahi Kasei's BL301 for JCAP assembly site.

This is an alternate polyimide material only; there are no changes to the WLCSF package structure or polyimide thicknesses because of this change. There are no changes to electrical parameters or part marking due to this alternate material.

The polyimide addition will apply to all devices shown in the affected part list (below), as well as future products released in this location.

Upon effectivity of this FPCN either passivation material may be utilized during manufacturing. Full traceability will be maintained, and there will be no mixing of materials within a lot.

	Polyimide Layer Before Change	Polyimide Layer After Change
PI layer name	HD4100	HD4100 or BL301
Supplier name	HD Microsystems	HD Microsystems or Asahi Kasei



Qualification Plan:

QV DEVICE NAME: LC898129DP1XHTBG

RMS: 76808

PACKAGE: WLCSP40 1.60x4.15x0.33

Test	Specification	Condition	Interval
HTSL	JESD22-A103	Ta = 125°C	1008 hrs
TC	JESD22-A104	Ta = -40°C to +125°C	500 cyc
HAST	JESD22-A110	110°C, 85% RH, 17.7psig, bias	264 hrs
uHAST	JESD22-A118	110°C, 85% RH, 17.7psig, unbiased	264 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C	

Estimated date for qualification completion: 20 September 2021

List of Affected Parts:

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the **PCN Customized Portal**.

Part Number	Qualification Vehicle
LC898262XHTBG	LC898129DP1XHTBG
LC898129DP1XHTBG	LC898129DP1XHTBG
LC898128DP1XGTBG	LC898129DP1XHTBG

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。

初回製品 / プロセス変更通知

文書番号 : IPCN23955X

発行日 : 01 Apr 2021

変更件名:	JCAP における代替ポリイミド材料の追加	
初回出荷予定日:	17 Dec 2021 またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前	
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または < Keiji.Ueda@onsemi.com > にお問い合わせください。	
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または < PCN.Samples@onsemi.com > にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。 サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。	
通知種別:	これは、お客様宛の初回製品 / プロセス変更通知 (IPCN) です。IPCN は、近日中に実施される変更に関する事前通知であり、変更の詳細および影響を受けるデバイスについての一般情報が記載されます。また、暫定的な信頼性認証計画も記載されます。 最終的な認定データおよび特性データは最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に含まれます。この IPCN は、変更実施から少なくとも 90 日前に発行される最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に先だって通知されます。ご不明な点がありましたら、< PCN.Support@onsemi.com > にお問い合わせください。	
部品のマーキング/変更のトレーサビリティ:	影響を受ける製品は日付コードによって追跡可能です。	
変更カテゴリ:	組立の変更	
変更サブカテゴリ:	材料の変更	
影響を受ける拠点:		
外部製造工場 / 下請業者拠点:	外部製造工場 / 下請業者拠点:	
なし	JCAP, China	
説明および目的:	<p>この初回変更通知は、JCAP 組立拠点において、旭化成の BL301 による代替のポリイミド材料 (リパッシベーションレイヤー) を追加することをお知らせするものです。</p> <p>これはポリイミド材料を代替するだけであり、本変更によって WLCSP パッケージ構造またはポリイミドの厚さに変更は生じません。この代替材料による電気パラメータまたは製品マーキングの変更はありません。</p> <p>ポリイミドの追加は、影響を受ける部品の一覧 (下記) に示すすべての製品、そしてこの拠点でリリースされる今後の製品に適用されます。</p> <p>本件の FPCN の発効日から、どちらのパッシベーション材料も製造時に利用することができます。引き続き完全に追跡可能であり、ロット内で材料が混在することはありません。</p>	
	変更前のポリイミドレイヤー	変更後のポリイミドレイヤー
PI レイヤー名	HD4100	HD4100または BL301
サプライヤ名	HD マイクロシステムズ	HD マイクロシステムズまたは旭化成

初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN23955X

発行日 : 01 Apr 2021

認定計画 :

デバイス名 : LC898129DP1XHTBG

RMS : 76808

パッケージ : WLCSP40 1.60x4.15x0.33

テスト	規格	条件	間隔
HTSL	JESD22-A103	Ta = 125°C	1008 hrs
TC	JESD22-A104	Ta = -40°C to +125°C	500 cyc
HAST	JESD22-A110	110°C, 85% RH, 17.7psig, bias	264 hrs
uHAST	JESD22-A118	110°C, 85% RH, 17.7psig, unbiased	264 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C	

認定完了予定日 : 20 September 2021

影響を受ける部品の一覧 :

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
LC898262XHTBG	LC898129DP1XHTBG
LC898129DP1XHTBG	LC898129DP1XHTBG
LC898128DP1XGTBG	LC898129DP1XHTBG